

(19) 대한민국특허청(KR)
 (12) 공개특허공보(A)

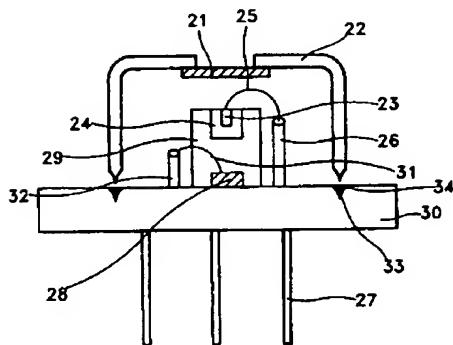
(51) Int. Cl. H01S 3/18	(11) 공개번호 특1995-0012911
(21) 출원번호 특1993-0022314	(43) 공개일자 1995년05월17일
(22) 출원일자 1993년10월26일	
(71) 출원인 삼성전자 주식회사, 김광호 대한민국 440-370	
(72) 발명자 이상호 대한민국	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지(440-370)
(74) 대리인 이영필	경기도 수원시 팔달구 매탄2동 196-41번지
	박영우
	이윤민
(77) 심사청구 없음	
(54) 출원명 반도체 레이저 다이오드 어셈블리	

요약

본 발명은 광 기록 매체, 광 통신 및 항공우주 분야에 핵심부품으로 사용되는 반도체 레이저 다이오드 어셈블리에 관한 것으로, 캡웰딩(Cap Welding)방법을 개선함으로써, 보다 내부 밀폐 효과가 좋아지고, 작업방법이 간단하게 되어 제품 자체의 신뢰성이 향상된 레이저 다이오드 어셈블리 및 그 제조방법에 관한 것이다.

보다 구체적으로는, 본 발명의 레이저 다이오드 어셈블리는 스텝베이스(30)에 폭 500μm~1000μm, 깊이 1mm~2mm정도의 V자형의 흉(V-groove)을 만들고, 캡 하단부를 빼기 모양으로 만들어 캡 웰딩(Cap Welding)시 일착도를 높여 우수한 내부 밀폐 효과 및 캡 어라인을 통한 레이저 다이오드 어셈블리의 수율을 향상시키는데 본 발명의 특징이 있다. 더욱이 작업 방법 또한 간단하여 저가의 웰딩(Welding)장비를 사용할 수 있어, 조립원가의 절감을 도모할 수 있다는 장점이 있다.

■ 2 도



대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

반도체 레이저 다이오드 어셈블리

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 따른 레이저 다이오드 어셈블리의 수직 단면도를,

제3도는 본 발명에 따른 레이저 다이오드 어셈블리의 수평 단면도를 각각 도시한다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1.

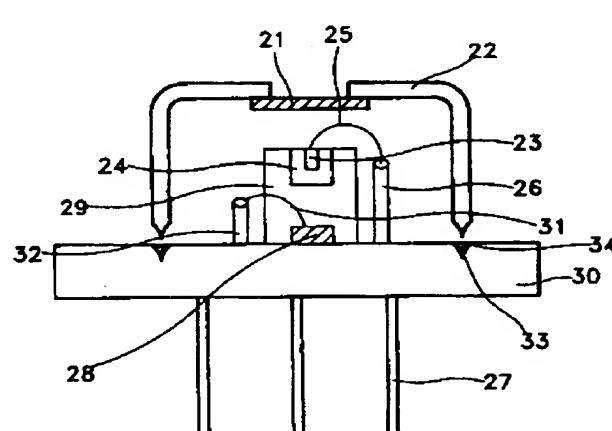
그 상면 중앙에 레이저 다이오드 칩이 탑재되어, 그 상면에 상기 레이저 다이오드 칩의 주위를 둘러싸는 소정의 깊이의 V자형의 홈(V-groove)이 형성된 스텀 베이스와, 상기 레이저 다이오드 칩으로부터의 레이저 빛이 출사되는 원도우와, 상기 V자형의 홈(V-groove)에 그 하단부가 소정의 깊이로 진입되는 스커트를 갖는 것을 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 레이저 다이오드 어셈블리.

청구항 2.

제1항에 있어서, 캡의 스커츠 하단부가 뺨기 모양으로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체 레이저 다이오드 어셈블리.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면 2



도면 3

